

# 点胶式液态导热垫片 XK-S30LV®

## Thermal Conductivity Silicone Gel

### 特性：

- 1:1混合 ( 流淌式 )
- 1:1mix(no cure by-product)
- 低应力应用
- low stress applications
- 操作方便
- Easy to Use
- 加热加速反应
- Hear Fast Cure



### 应用：

- 汽车电子
- Automotive electronics
- 通讯设施
- Telecommunications
- 计算机及周边产品
- Computer & peripherals
- 导热，减震
- Thermally conductive vibration dampening
- 热源与散热器间应用
- Between any heat-generating semiconductor and a heat sink

	XK-S30LV	METHOD	UNIT
Color / Part A	Blue	Visual	
Color / Part B	White	Visual	
Features	Soft GEL	-	-
Density	3.1	ASTM D792	g/cm3

#### Before Cured Property

A:B	1:1	-	-
Mixed Viscosity (20rpm)	100,000	ASTM D2196	Cps
Shelf Life @ 25°C	6 month		

#### After Cured Property

Color	Blue	Visual	-
Cure Schedule 1	24hr/25°C		
Cure Schedule 2	100min/80°C		
Cure Schedule 3	10min/100°C		
Pot life	30 min/25°C		
Hardness	Shore 00 = 80	ASTM D2240	
	AskerC = 35	JIS K7312	
Tensile Strength.	>0.2	ASTM D412	Mpa
Elongation	80	ASTM D412	%
Continuous Use Temp	-60~200		°C

#### Electrical Property

Dielectric strength	>10	ASTM D149	KV/mm
Volume resistivity	>10 <sup>13</sup>	ASTM D257	Ohm-cm
Dielectric Constant	8	ASTM D150	(1KHz)
Flame Rating	V-0	UL94	

#### Thermal Property

Thermal Conductivity	3.0	ASTM D5470	W/m*K
Heat Capacity	1	ASTM E1269	J/g-K

## 使用操作程序:

1. AB 比例 1:1 , AB 胶两剂要混合均匀
2. 使用工具: 自动点胶机 或 手动供料枪
3. 熟化时间与点胶量(成品厚度) 有关

Curing temperature °C	Curing time
25	24 hr~48Hr
50	200~300min
80	100~200min
100	10~20min
150	1~3 min

### 注意要点

#### 接触面:

如果与含硫磺,磷,氮气化物,氮及含有机金属盐等物质接触时,阻害其表面硬化,轻微者阻害其表面与接触面的硬化,严重者造成永久,完全性不硬化.

#### 环境面:

除要求混合比例之正确外,在混胶使用之容器(如:纸杯,塑料杯...),因为容器内壁之油脂,塑料中可塑剂的渗透关系,烤箱内部因为烘烤过环氧树脂,凡立水..等,会造成污染

因此在使用之前,清扫并干燥机器,特别是与上述物质有接触可能,请先行做试验

### 保存方法

1. 保存方式,在未混合使用前,室温 25 度以下可保存 12 个月
2. AB 剂混合后需一次用完,无法留至日后继续使用